

特点:

- 高带外抑制:

$$f_0 \pm 170\text{MHz} \geq 40\text{dB}$$

- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: $16.2 \times 8.0 \times 5.4\text{mm}^3$
- 产品执行标准为 SJ20764-1999

图片:
性能参数: (25℃)

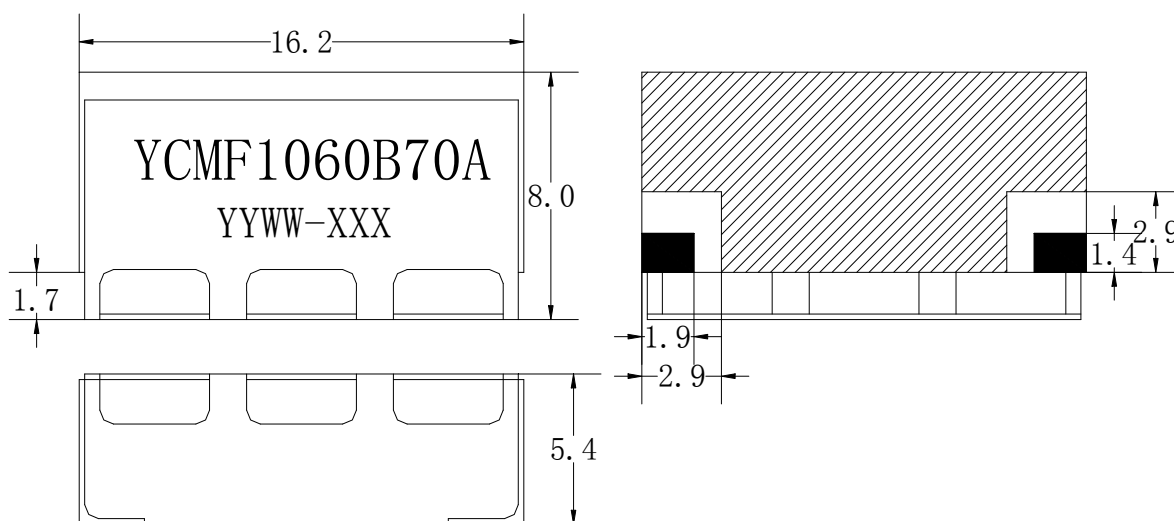
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	f_0		1060±3			MHz	
-3dB 带宽	BW_{-3dB}		80		92	MHz	全温
插入损耗	IL	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=1060\text{MHz}$		2.5	3.0	dB	全温
输入带内驻波比	$VSWR_i$	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=1025 \sim 1095\text{MHz}$		1.5:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	$VSWR_o$			1.5:1	2.0:1		全温
阻带抑制	SR_1	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=1 \sim 890\text{MHz}$	40			dB	全温
	SR_2	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=1230 \sim 1500\text{MHz}$	40			dB	全温
端接阻抗	Z			50		Ω	
工作温度	T		-55		+85	℃	
质量	m				10.0	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位
储存温度	-55~+100	℃
输入射频功率	30.0	dBm

封装外形及引脚标识图:

单位: mm 公差: ±0.3mm





表面处理: 陶瓷介质镀银, 屏蔽罩镀镍。

字符标志:

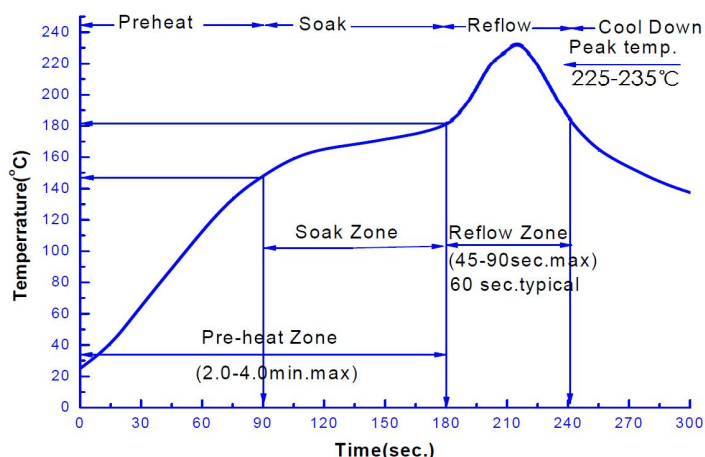
YCMF1060B70A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

接口标识	接口说明
	RF IN, RF OUT (可互换)
	GND

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，推荐采用采用组份 $\geq 2\%$ 的含银焊膏回流焊接，回流温度推荐曲线：



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
7. 其他使用注意事项参考成都宇熙《微波介质陶瓷滤波器产品使用说明》。